

2019年度 京セラ株式会社 募集要項

1. 採用予定

【応募資格】

2019年3月 四年制大学卒業及び大学院修了見込みの方
(浪人・留年については原則として計2年以内を目安とさせていただきます)

【採用予定】

理工系 200名 程度 — 男 163名

【採用学科】

電気・電子系/情報・通信系/機械系/制御系/物理系/化学系/材料系/その他(知的財産 他)

【求める人材像】

- ・ 夢に向かって果敢にチャレンジし続けられる人
 - ・ 素直な心、ひたむきさを持っている人
 - ・ グローバルな視点を持っている人
- (今後の事業のグローバル展開を踏まえ、目安としてTOEIC600点相当の語学力がある方は、更に歓迎します)

【専攻分野と採用比率目安】

電気・電子/情報・通信系	機械/制御系	化学/材料系	物理系	その他
30%	30%	30%	5%	5%

2. 応募方法

(1) 修士・学部の方の応募方法について

次の2コース(プロダクト別採用コース/職種別採用コース)より選択いただき、ご応募ください。

※上記コースの併願はできません。

※各プロダクト・職種の詳細、応募方法の詳細は添付別紙「応募に際しての留意事項」及び「応募概要」をご参照ください。

【1】プロダクト別採用コース(対象:学校推薦応募者限定)

弊社へ学校推薦応募を検討されている方は、ご本人が希望するプロダクトへの配属を前提に、マッチング面談・選考に進んでいただけます。「マッチング面談会」ではご本人が希望される「プロダクト」と「技術専門性・応用性」(学部生の場合は「学業の理解度とポテンシャル」)について、該当部門との適性を確認いたします。

※①～⑯のうち、2つのプロダクト(第1希望/第2希望)を選択してください。

※6月1日以降にご応募いただいた場合には、配属先のプロダクトを限定しない採用方法に変更させていただく可能性があります。あらかじめご了承ください。

対象プロダクト:

- | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|
| ① ファインセラミック部品 | ② 車載用部品・車載カメラ | ③ セラミックパッケージ・基板 | ④ 有機パッケージ・基板 |
| ⑤ ケミカル材料 | ⑥ 切削工具 | ⑦ 医療機器 | ⑧ 宝飾・応用商品 |
| ⑨ エネルギーデバイス・システム(SOFC・EMS) | ⑩ 電子部品(コンデンサ、コネクタ、パワーデバイス、水晶デバイス) | ⑪ 生産技術開発・精機 | ⑫ 液晶 |
| ⑬ プリンティングデバイス | ⑭ ソフトウェア開発 | ⑮ 光学用部品 | |

【2】職種別採用コース (対象:学校推薦・自由応募者どちらでも可)

次の職種については、職種ごとに適性を確認し、該当部門への配属を前提に、マッチング面談・選考に進んでいただけます。

※⑰～⑲のうち、1つの職種のみ選択してください。

対象職種: ⑰ 特許・知的財産 ⑱ 情報ネットワーク・システムエンジニア ⑲ 施設管理 ⑳ 安全防災

(2) 博士の方の応募方法について

応募を検討される際は、ご本人からの連絡をお願いいたします。応募時に、まず論文審査をさせていただきます。

履歴書並びに専門分野に関する論文を弊社担当宛にご郵送ください。論文審査合格の方に、選考に関してご案内いたします。

※博士課程の方については随時受付いたします。

(3) 理工系の知識を活用する「営業職」への推薦応募方法について

京セラでは、理工系の知識を活用して「営業職」として活躍いただける方についても、学校推薦での応募を受け付けております。

応募・選考方法が通常と異なりますので、ご希望の場合には弊社担当宛にご連絡ください。

(4) 留学生の方の応募方法について

学校推薦で応募を希望される場合には、事前に弊社担当宛にご相談ください。

(5) 自由応募の方の応募方法について

応募コース、選考方法が学校推薦応募の方法と異なります。

弊社HPのマイページをご確認の上、ご応募ください。

<技術系採用書類送付・お問い合わせ先>

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地
京セラ株式会社 人材開発課(技術採用担当) 田中・今野

E-mail: misato.tanaka.nf@kyocera.jp, shingo.konno.yb@kyocera.jp

TEL : 075-604-3510 (直通)

※各コースへの応募書類ご郵送の際は、封筒に「〇〇採用コース応募書類在中」と記載いただきますようお願いいたします。

京セラへの応募をお考えの方は

『京セラ プロダクト・職種別合同セミナー』へ

ぜひ、ご参加ください! 各プロダクトより、事業内容や最先端技術仕事の魅力をご紹介します!

【全国3か所で開催】

京都 3月15日(木) 横浜 3月18日(日) 博多 3月21日(水)

「プロダクト別採用コース」「職種別採用コース」応募概要

※プロダクト別採用コースについては、学校推薦応募をお考えの方に限定させていただきます。

STEP.1 マッチング面談会

◆マッチング面談会の内容:

ご希望のプロダクト(第2希望まで)の部門責任者と面談
 ※面談結果は、面談終了後、2週間以内に就職担当教授様
 もしくはキャリアセンター担当者様へフィードバックさせていただきます。

(1) 面談会申込方法

1. 大学 ⇒ 弊社へご連絡	就職担当教授様もしくはキャリアセンター担当者様より面談会参加希望学生を弊社担当までご連絡ください。
2. ご本人 ⇒ 弊社HPからエントリー	<面談会申込連絡内容> ① 学生氏名 ② 学部/研究科名 ③ 学科/専攻名 ④ 就職担当教授様もしくはキャリアセンター担当者様のご連絡先をメール又はお電話で弊社担当へご連絡ください。
3. ご本人 ⇒ マイページから応募データ入力	「マイページ」より、次の3点を入力し、データを送信してください。 ① 「自己紹介シート」 ※面談資料として使用します ② 「成績情報」 ※修士の方は学部部分も必要です ③ 「面談結果連絡先(就職担当教授・キャリアセンター等)」 ※自己紹介シートについては、研究概要等も入力いただくため、時間を要します。入力の際は、余裕を持って行ってください。
4. ご本人 ⇒ データ送信・連絡	データ送信されましたら、弊社担当 田中・今野までメールにてご連絡ください。 ※メールの送り先はお問い合わせ先参照

(2) 面談会申込締切

- ① 第1回受付 4月11日(水) データ送信到着分まで
 - ② 第2回受付 5月14日(月) データ送信到着分まで
 - ③ 第3回受付 6月6日(水) データ送信到着分まで
- ※各日程ともに、締切は23:59までのデータ送信分を受付いたします。

(3) 面談会開催日程 ※予定

- ① 第1回受付の方 4月21日もしくは22日
- ② 第2回受付の方 5月26日もしくは27日
- ③ 第3回受付の方 6月中旬以降

※面談にご参加いただく日程については、選択いただくことはできません。
 ※選択されたプロダクトによっては、面談が2日間にまたがる場合もあります。
 あらかじめご了承ください。

(4) 面談場所

京都本社を予定しています。
 ※都合により、一部変更する場合があります。

(5) 交通費について

遠方者につきましては、弊社規定により交通費を補助いたします。
 (詳細は面談日時のご案内の際に連絡いたします。)

(6) マッチング面談会参加準備

1. 弊社 ⇒ ご本人へ日程の連絡	応募データ到着後、弊社よりWEB検査やSPI検査、面談日時・場所について、メールにて連絡いたします。
2. ご本人 ⇒ Web適性検査・SPI検査の受検	面談日の2日前までに、次の検査を受検ください。 ① マイページより「WEBテスト・適性検査」を受検してください。 ② SPIテストセンターにて「SPI検査」を受検してください。
3. ご本人 ⇒ 面談資料作成	◆下記資料2点を面談当日にご持参ください。 ① 技術PR資料(A4/1~3枚、形式自由) ⇒ ご自身の研究内容についてのPR資料 ② 自己PR資料(A4/1枚、形式自由) ⇒ 研究内容以外で自分を紹介するPR資料 面談当日、各10分程度ご持参ください。 事前に送っていただいた「自己紹介シート」「成績情報」とご持参いただいた資料をもとに、面談を実施いたします。 推薦書またはそれに準ずる資料を当日ご準備いただける方は、ご持参ください。

(7) マッチング面談会結果フィードバックについて
 面談終了後、(2週間以内) マッチング結果を就職担当教授様もしくはキャリアセンター担当者様へ電話又はメールにてフィードバックさせていただきます。

(8) 推薦状の発行について
 マッチングが成立した場合には、学校推薦を確定していただき、書類提出の準備をしてください。

STEP.2 最終選考

◆最終選考内容: 面接 6/4

※原則として、面談でマッチング成立となったプロダクトへの配属を前提として、選考を行います。

(1) 最終選考にあたって

1. ご本人 ⇒ 推薦書を送信	マッチング成立の連絡をさせていただいた後、弊社担当まで速やかに推薦書をご郵送ください。 ※期日は、成立された方にそれぞれ案内いたします。
--------------------	---

(2) 最終選考参加準備

1. 弊社 ⇒ ご本人へ日程の連絡	最終選考日が決定次第、弊社より日時・場所をご本人へメールにて連絡いたします。
----------------------	--

<最終選考にご持参いただく書類>

- ① 推薦書
- ② 修了見込証明書
- ③ 健康診断書
- ④ 成績証明書(学部・修士)の原紙

※推薦書は、学部長・就職担当教授様・指導教授様のどなた様からでも結構です。

<選考に際しての注意事項>

◆大学の都合により、マッチング成立後、推薦の決定または推薦状の発行までに日数がかかる場合には、事前に弊社担当へご相談ください。

(3) 最終選考日程

6月以降随時
 ※応募書類が到着した順にご本人へ選考の詳細をご案内いたします。

(4) 最終選考場所

東京、京都、博多を予定

(5) 交通費について

最終選考については、弊社規定によりご自宅から面接会場までの交通費を全額支給いたします。

<技術系採用書類送付・お問い合わせ先>

〒612-8501 京都市伏見区竹田島羽殿町6番地
 京セラ株式会社 人材開発課(技術系担当) 田中・今野
 E-mail: miseto.tanaka.nf@kyocera.jp, shingo.konno.yb@kyocera.jp
 TEL: 075-604-3510 (直通)
 ※各コースへの応募書類ご郵送の際は、封筒に「〇〇採用コース応募書類在中」と記載いただきますようお願いいたします。

「職種別採用コース(推薦応募)の方」へ

応募、面談については、プロダクト別採用コースと同じ流れ(マッチング面談有)となります。

- ① マッチング面談の応募締切は、プロダクト別採用コースと同じ日程です。
 - ② マッチング面談日は、プロダクト別採用コースと併列日となります。
- ※ご応募いただいた方に、別途連絡いたします。

※最終選考は、プロダクト別採用コースのマッチング成立の方と同様に、6月以降を予定しています。

「6月1日以降に学校推薦で応募をされる場合の留意事項」

- ① 配属先のプロダクト、職種を限定しない応募方法に変更になる可能性があります。応募の際に弊社担当までお問い合わせください。
- ② 推薦応募が決定されましたら、就職担当教授様もしくはキャリアセンターご担当者様から弊社担当までご連絡ください。
- ③ 応募書類については、「マッチング面談会申込方法」と同様に、データ入力・送信を、マイページから行ってください。

自己紹介シート記入要領

【応募に際しての留意事項】

★ 応募前に必ず弊社採用HPより、エントリーください。 URL : <http://www.kyocera.co.jp/recruit/new/>
 エントリー後、ご自身のマイページより「自己紹介シート」及び「成績情報」を入力してください。

<自己紹介シート必要情報の入力に際して>

- (1) 「携わりたい技術分野」については、【技術分野】*表1より選択してご入力ください。(3つ以内)
- (2) 「希望するプロダクト及び職種」については、【プロダクト及び職種】*表2よりご選択ください。
 - ①プロダクト別採用コースの方 : プロダクト名称①~④から、2つご選択ください。 ※1つのみでの受験を強く希望される方は1つのみで結構です。
 - ②職種別採用コースの方 : 職種名称⑤~⑧から、1つのみご選択ください。
- (3) 「卒業・修了研究概要とねらい」について、研究テーマが未定の方・学部生の方は、現在の専攻に基づき最も関心を持っている研究分野もしくは最もご自身が得意とする分野とその理由について入力ください。

【携わりたい技術分野及びプロダクト詳細】 ※マイページでも確認いただけます。

◆表1 技術分野

・無機材料技術	・薄膜成膜技術	・パワーエレクトロニクス技術	・画像認識/画像処理技術	・振動/熱/流体関連技術
・有機材料技術	・微細加工技術	・電気特性評価技術	・ソフトウェア技術	・電池関連技術
・金属材料技術	・金属加工技術	・制御工学技術	・シミュレーション技術	・人工知能関連技術
・応用化学技術	・電気回路技術	・機械設計技術	・分析技術	・特許/知的財産管理技術
・材料特性評価技術	・電子回路技術	・機構設計技術	・信頼性工学技術	・情報システム管理技術
・セラミックプロセス技術	・高周波回路技術	・機械加工技術	・CAD/CAM技術	・施設管理技術
・電気化学技術	・情報通信技術	・光学設計技術	・IE/VE技術	・安全防災管理技術

※上記の◆技術分野について、該当する技術分野が無い場合には、自由にご記入ください。

◆表2 プロダクト及び職種

各プロダクト及び職種の内容については、「京セラ会社概要パンフレット」「京セラ新卒採用HP 製品紹介ページ」をご確認ください。
 ※HPの製品紹介ページについては、新卒採用HP内の「京セラについて」のタブよりご確認いただけます。

プロダクト及び職種 ※①~④については、どの事業にも、研究、開発・設計、製造技術、生産技術、品質評価技術等の職種があります。	専攻分野				
	電気・電子/物理系	機械・制御/物理系	情報・通信系	無機化学・材料系	有機化学・材料系
ファイナセラミックス部品関連					
①ファイナセラミックス部品 半導体・液晶製造装置用大型部品、サファイア単結晶製品、生活文化・産業機械用部品、環境・エネルギー関連用部品、医療機器用部品等	○	○	○	○	○
②車載用部品・車載カメラ エンジン部品、カーエレクトロニクス部品、車載カメラモジュール等	○	○	○	○	○
半導体部品関連					
③セラミックパッケージ・基板 <パッケージ> 半導体デバイス用パッケージ、通信デバイス用高周波パッケージ、電子部品用小型パッケージ、光半導体用パッケージ等 <基板> 車載エンジン制御用セラミック基板、LEDランプモジュール用セラミック基板等	○	○	○	○	○
④有機パッケージ・基板 <パッケージ> サーバー・ルーター・携帯端末用多層パッケージ等 <基板/配線板> 携帯端末・車載用通信モジュール基板、パソコン・携帯端末用高密度配線板、ハイエンドサーバー・通信システム用大型基板等	○	○	○	○	○
⑤ケミカル材料 半導体関連樹脂材料/半導体封止材料、半導体・電子部品組立材料、化成品、熱硬化性成型材料、機能性シート等	○	○	○	○	○
ファイナセラミックス技術応用関連					
⑥切削工具 超硬合金セラミックハイブリッド切削チップ、超硬合金ドリル、工業用精密ナイフ等	○	○	○	○	○
⑦医療機器 人工関節、デンタルインプラント等	○	○	○	○	○
⑧宝飾・応用商品 人工再結晶化宝石、ジュエリー装身具、セラミック応用キッチン用品、セラミック応用ステーションナリー・日用品等	○	○	○	○	○
⑨エネルギーデバイス・システム 燃料電池SOFC、リチウムイオン蓄電システム、HEMS(家庭用エネルギー管理システム)等	○	○	○	○	○
電子デバイス関連					
⑩電子部品 コンデンサ、コネクタ、パワーデバイス(SAWフィルタ、高周波通信モジュールも含む)、水晶デバイス(水晶振動子、水晶発振器、光デバイス)等	○	○	○	○	○
⑪プリンティングデバイス 高速商業用インクジェットプリントヘッド、サーマルプリントヘッド、トナー方式プリンタ用アモルファスシリコン感光ドラム等	○	○	○	○	○
通信機器関連					
⑫通信機器 高齢者スマートフォン、携帯電話、IoT用小型通信モジュール等	○	○	○	○	○
ソフトウェア関連					
⑬ソフトウェア開発 組み込みソフト開発、IoT・センサーネットワーク等の情報基盤技術開発、ビッグデータ・ヘルスケア等のサービスアプリケーション開発、画像処理・画像認識開発 人工知能等の先端ソフトウェア技術開発等	○	○	○	○	○
生産技術開発関連					
⑭生産技術開発・精機 メカトロ技術開発、製造プロセス開発、設備製造(開発・設計・製作)等	○	○	○	○	○
その他技術関連					
⑮特許・知的財産 事業戦略の一翼を担う知財戦略の立案・実行、自社発明の権利化・保護、他社とのライセンス契約関連業務等	○	○	○	○	○
⑯情報システム・ネットワークエンジニア 社内情報システムネットワークの企画・開発、保守管理等	○	○	○	○	○
⑰施設管理 省エネ推進、電気設備設計、保守等	○	○	○	○	○
⑱安全防災 労働安全衛生管理、消防防災管理、健康管理業務等	○	○	○	○	○